

R&D 計測・検査技術関連文献一覧表 (Vol.48, No.3 ~ Vol.57, No.2)

Papers on Advanced Technologies for Measurement and Inspection Technology in R&D Kobe Steel Engineering Reports (Vol.48, No.3 ~ Vol.57, No.2)

	巻 / 号
● 赤外線サーモグラフィによる応力評価に対する面外曲げ変形の影響 田村栄一ほか Effect of Out-of-plane Bending on Evaluation of Stress Distribution Using Infrared Thermography	57/2
● 低温ポリシリコン TFT プロセスにおける結晶欠陥の評価 - ライフタイム測定技術の応用 - 住江伸吾ほか Crystallinity Evaluation in Low-Temperature-Poly-Silicon TFT Manufacturing Process - Application of Lifetime Measurement -	57/1
● 音響診断による発電所設備異常監視 小山武志 Online Power Plant Acoustical Abnormality Monitoring System	56/2
● 振動法による非接触板張力計測技術 上田宏樹ほか The Untouched Measurement Technique for the Plate Tension Using Vibration	56/1
● 鋳鍛鋼品向け自動超音波探傷装置 岡本 陽ほか Automatic Ultrasonic Inspection System for Steel Castings and Forgings	55/3
● 光干渉法によるウェーハの精密形状計測 森本 勉ほか Precise Measurement of Wafer Geometry Using Interferometric Methods	55/1
● 大立体角ラザフォードバックスキャタリング分析装置の開発 小林 明ほか Development of a New Spectrometer for Rutherford Backscattering Spectrometry	55/1
● 透過型電子顕微鏡による鋼のさびのナノ組織評価 坪川純之ほか Nanoanalysis of Steel Rust by Transmission Electron Microscopy	55/1
● 後方散乱電子回折像法 (EBSP 法) による Y ₂ O ₃ 添加ジルコニアの組織評価 与田利花ほか Microstructural Analysis of Y ₂ O ₃ -stabilized Zirconia by EBSP (Electron backscatter diffraction pattern)	55/1
● SR-XAFS を用いた金属間化合物の局所構造解析技術 渡部 孝 Application of SR-XAFS to Study Chemical Bonding States and the Structural Analysis of Inter-metallic Compounds	55/1
● AES-REELS を用いた炭素材料の局所構造解析技術 渡部 孝 The Application of AES-REELS in the Study of the Chemical Bonding State and Structural Analysis of Carbon Materials	55/1
● 超音波を利用したスタックタイプパッケージの微小欠陥の評価法 上野一也 Ultrasound Evaluation of Chip Stacked Packages with Micro Defects	55/1
● 溶接ロボットへのレーザセンサの応用 重吉正之ほか Application of Laser Sensors to Welding Robots	54/2
● 高分解能 RBS 分析装置 森 芳一ほか A High Resolution RBS System	52/2

● 高分解能 RBS のシミュレーションによるスペクトル解析	一原主税ほか	52/2
Analysis of High Resolution RBS Spectra Using Simulation		
● 高分解能 RBS による薄膜評価	笹川 薫	52/2
Thin Film Analysis using a High Resolution RBS System		
● 高分解能結晶方位解析法 (FESEM/EBSP 法) による薄膜材料の配向性評価	与田利花ほか	52/2
Orientation Analysis of Thin Films with FESEM/EBSP Technique		
● プラズマチャージアップダメージ評価ウェーハの開発	福本吉人ほか	52/2
Development of Plasma Charge-up Damage Evaluation Wafers		
● 半導体プロセスにおける重金属汚染の検出 - キャリアライフタイム測定装置 -	住江伸吾ほか	52/2
Detection of Heavy Metal Contamination in Semiconductor Processes Using a Carrier Lifetime Measurement System		
● ケーブル張力と曲げ剛性の同時推定法	山極伊知郎ほか	49/2
Simultaneous Identification of Tension and Flexural Rigidity of Cables		
● TOFD 法による橋梁溶接試験体の超音波探傷	村井康生ほか	49/2
Ultrasonic Testing of Welded Joint Models for Bridge Construction Based on the TOFD Method		
● 半導体デバイスの評価・解析技術	山元清史ほか	48/3
Analytical Techniques for Semiconductor Devices		